OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

BERGQUIST GAP FILLER TGF 1100SF

BERGQUIST GAP FILLER TGF 1100SF
Thermally Conductive, Silicone-Free, Two-part, Low Modulus, Liquid Gap Filling Material



- Lämmönjohtavuus: 1.1 W/m-k
- Ei silikonin uloskaasua tai uuttumista
- Erittäin sopeutuva, suunniteltu herkille ja vähärasitteisille sovelluksille
- Kovettuu huoneenlämmössä nopeutetulla aikataululla
- 100 % kiinteä aine - ei kovettavia sivutuotteita

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® GAP FILLER TGF 1100SF on lämpöratkaisu silikonille herkkien sovellusten tarpeisiin. Materiaali toimitetaan kaksikomponenttisena ja kovettuu huoneenlämmössä tai kohotetuissa lämpötiloissa. Materiaali osoittaa alhaisen moduluksen ominaisuuksia ja kovettuu sitten pehmeäksi, joustavaksi elastomeeriksi, mikä auttaa vähentämään lämpösyklin aiheuttamia rasituksia käytön aikana ja käytännössä eliminoi rasitukset vähärasitussovellusten kokoonpanon aikana.

Kaksi komponenttia on värjätty sekoituksen ilmaisemiseksi (1:1 tilavuudeltaan). Sekoitettu järjestelmä kovettuu huoneenlämpötilassa. Toisin kuin kovettuneet lämpötyynymateriaalit, neste-menetelmä tarjoaa loputtomia paksuusvaihtoehtoja vähäisellä tai olemattomalla rasituksella kokoonpanon aikana. Vaikka BERGQUIST GAP FILLER TGF 1100SF osoittaa joitain luonnollisen tarttuvuuden ominaisuuksia, sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi mekaanisesti rakenteellisen sidoksen vaativissa lämpöliitossovelluksissa.

Vaihtoehdot ja kokoonpanot

Täytehelmet - Ei täytehelmiä, 0,007 tuuman täytehelmiä
Työaika - 240 minuuttia
Kartuusit - 50 cc, 400 cc
Paketit - 1200 cc, 10 gallonaa